

**关键指标**

频率: DC~30GHz  
 插入损耗: 2.4dB  
 隔离度: 40dB  
 电压/电流: -5V/1mA  
 控制电平: 0/+3.3V, 0/+5V  
 芯片尺寸: 1.25mm×0.95mm

**产品简介**

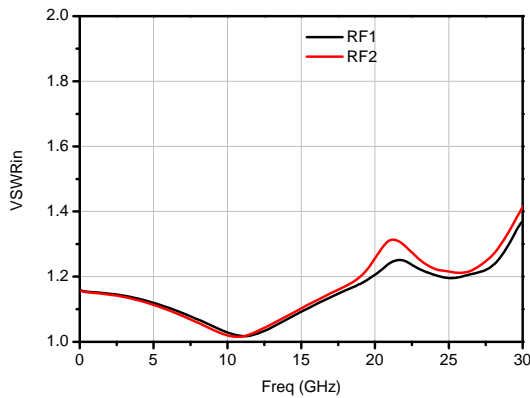
HG127KC/HG127KC(M)是一款 DC~30GHz 吸收式单刀双掷开关芯片, HG127KC 与 HG127KC(M)是一对镜像开关, 外形相同, 控制相反, 均集成驱动控制器。

电性能 (TA=25°C, VEE=-5V)

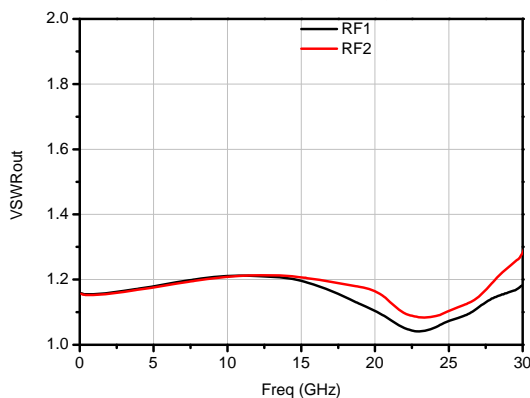
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~30		
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.2	-
插入损耗(dB)	-	2.4	-
隔离度(dB)	-	40	-
静态电流 (mA)	-	1	-

**典型测试曲线**

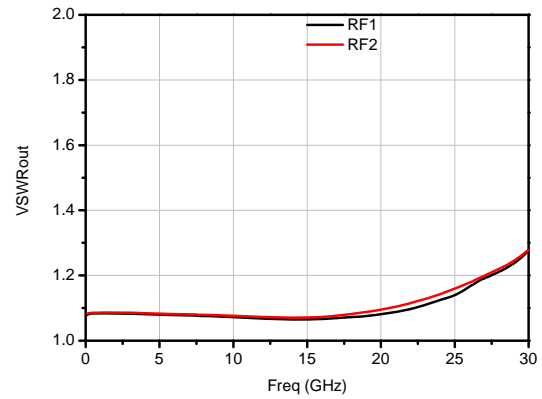
输入驻波



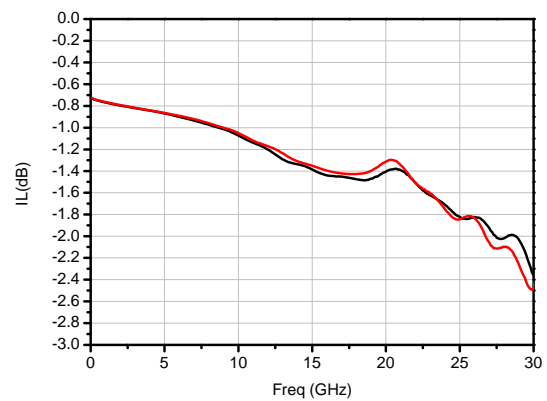
输出驻波(导通态)



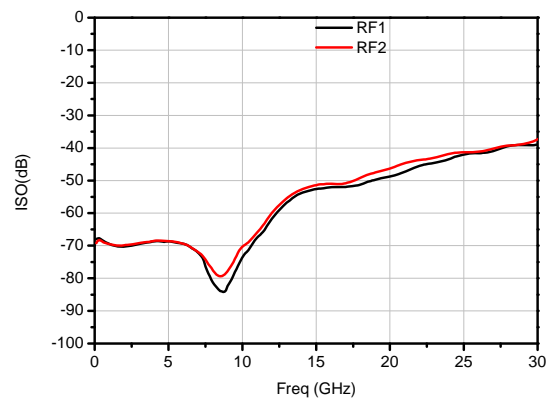
输出驻波 (关断态)



插入损耗



隔离度



**HG127KC 开关真值表**

VEE	C1	RFC-RF1	RFC-RF2
-5V	0V	ON	OFF
-5V	3V~5V	OFF	ON

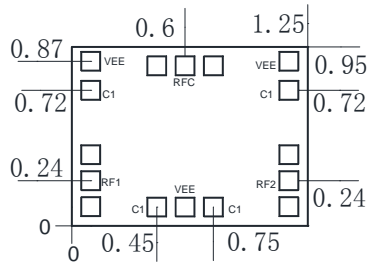
**HG127KC(M)开关真值表**

VEE	C1	RFC-RF1	RFC-RF2
-5V	3V~5V	ON	OFF
-5V	0V	OFF	ON

### 绝对额定最大值

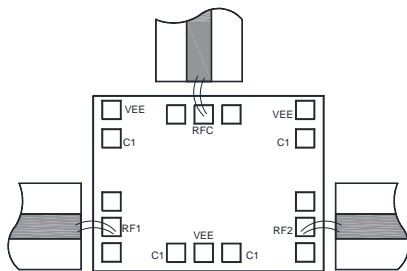
最大输入功率	+27dBm	
工作电压	-5.5V	
控制电压	低电平: 0~0.5V	高电平: 3~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

### 外形和端口尺寸 (mm)



### 推荐装配图

注： VEE 加电端与 C1 控制端口各任选 1 个即可。



### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。